

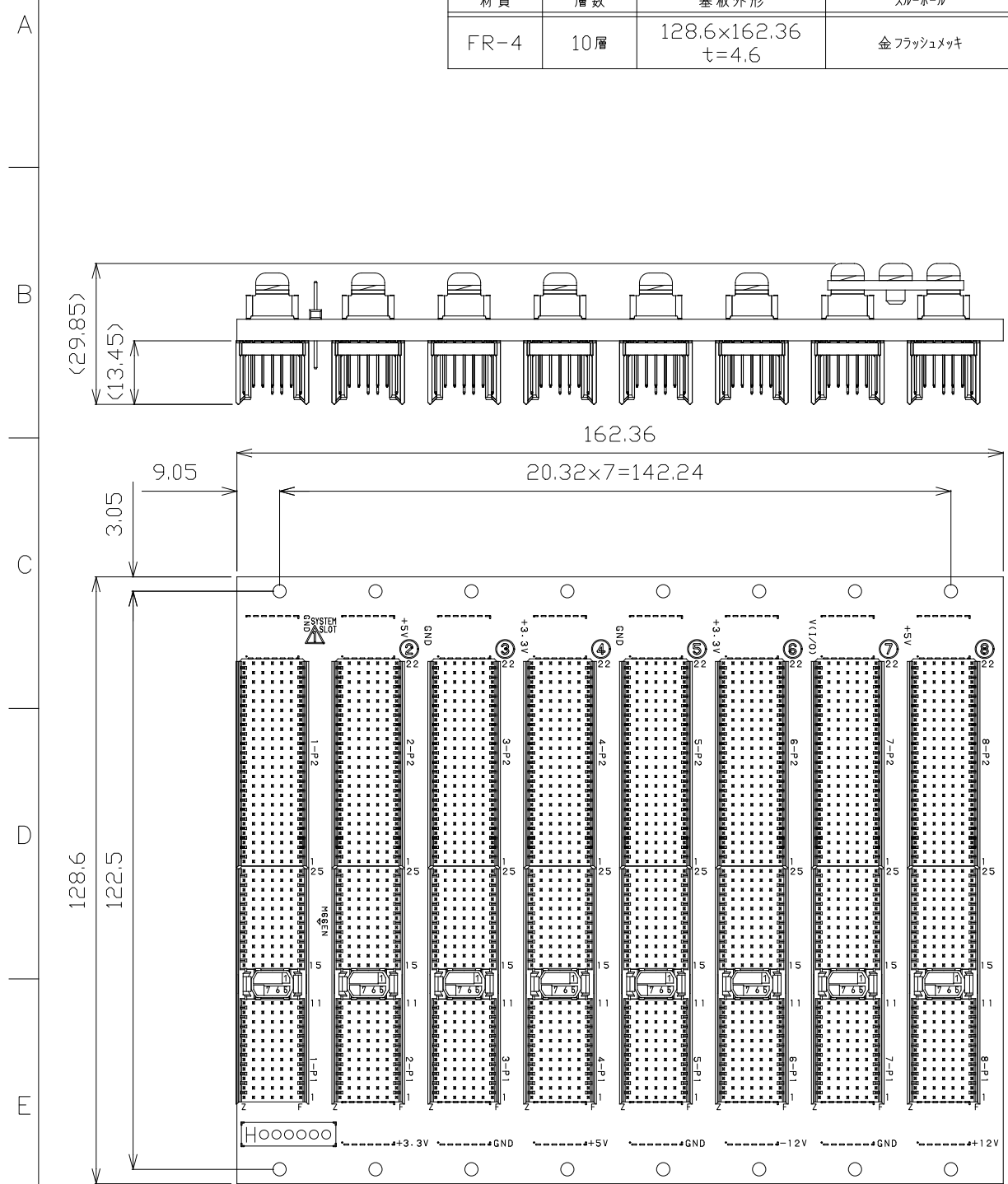
< 基板仕様 >

材質	層数	基板外形	スル-ホール
FR-4	10層	128.6×162.36 t=4.6	金フラッシュメッキ

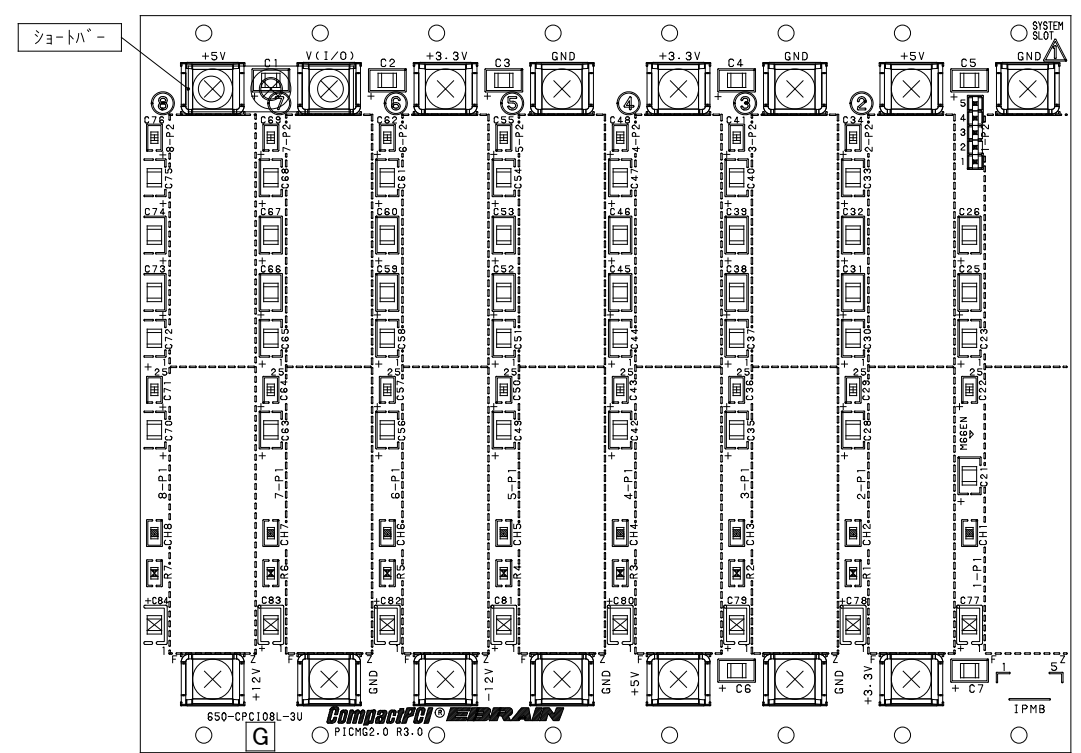
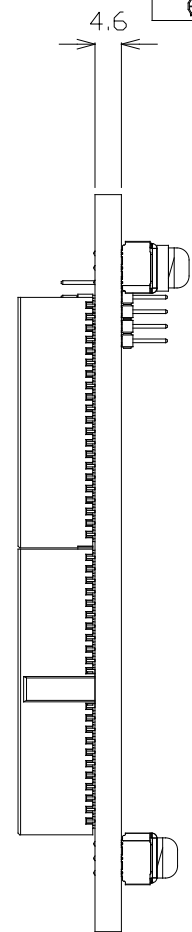
< 部品構成 >

記号	部品名	型番	メーカー	数量
P2	HMコネクタ	P2:TYPE-B ショト 22列 178071154000482P+	KYOCERA	8 SLOT
P1		P1:TYPE-A ショト HSP仕様 178071154508863P+		
☒	電源端子 30A M4	60800-578	シロフ	13
—	システム P/F	P12957-ZZZ(SHW-32GM(P/F))	E BRAIN	5/32P
□	スイッチ	CAS-120TA1	コルパ電子	8
□	セラミックコンデンサ 22μF	EMK325BJ226MM-T	太陽誘電	46
□	セラミックコンデンサ 10μF	TMK325BJ106MM-T	太陽誘電	8
□	セラミックコンデンサ 0.1μF	UMK212BJ104KG-T	太陽誘電	15
□	セラミックコンデンサ 0.01μF	UMK212B7103KGHT	太陽誘電	8
□	抵抗 30Ω	ERJ6GEYJ300V	Panasonic	7
□	コアレスインダクタ 0.43347	043347	ERNI	8

版	改 版 履 歴	年月日
1	初版発行 担当 梅木 査間 木村 承認 斉藤	20.02.10



部品面視



半田面視

鉛フリ-半田	電源容量 30A	HSP仕様
V(I/O)=5V		

RoHS対応品

CompactPCI®			PICMG2.0	REV3.0	尺 度 4/5	第三角法
担当	査間	承認	650-CPCI08L-3U-G		部品番号	P31840-1D
梅木	木村	斉藤	外 観 図		P31840-1C	
20.02.10	20.02.10	20.02.10			Rev. 1	SheetNo. 1 of 1